

硬脆材料のドライエッチング と微細加工技術セミナー

2018
11/21
[水]

主催 新潟県工業技術総合研究所

後援 (公財) にいがた産業創造機構

新潟県工業技術総合研究所では今年度、産学官共創ものづくり推進事業「硬脆材料のドライエッチングに関する調査研究」を行っています。ここでは半導体製造技術に使われていたドライエッチングを、硬脆材料の加工に用いるための課題について調査しています。本セミナーでは、当該事業の概要周知を目的に、ドライエッチング加工の紹介に加えて、電子ビーム、イオンエッチングといった新しい微細加工技術の紹介やその応用事例について紹介いたします。

- 日 時：平成 30 年 11 月 21 日（水） 13:30～16:00(受付開始 13:00)
- 場 所：新潟県工業技術総合研究所 中越技術支援センター 2階 研修会議室
(〒940-2127 長岡市新産 4-1-14)
- プログラム
- (1) 開会挨拶、硬脆材料のドライエッチングに関する調査研究の紹介 13:30
- (2) 講演
- ①「プラズマドライプロセスの加工とその応用技術」 13:40～14:40
立山マシン株式会社 事業推進室 人母 岳 氏
— 休 憩 — 14:40～14:50
- ②「最近の微細加工技術動向」 14:50～15:50
株式会社エリオニクス 営業部 清野 悠太 氏
- ③質疑応答 アンケート記入 15:50～16:00
- (3) 閉会挨拶 16:00
- 定 員：30 名
- 参 加 費：無料
- 申込締切：平成 30 年 11 月 16 日（金）

※手話通訳等を希望される方は 11 月 2 日(金)までにお申込みください。

参加申込み

お申し込み先:新潟県工業技術総合研究所 レーザーナノテク研究室 丸山 宛

E-mail hmaru@iri.pref.niigata.jp TEL 0258-47-5171 FAX 0258-47-5172

※手話通訳等を希望される方は右端の欄に「○」を記入してください。

会社名/組織名				
連絡先(TEL・FAX)		TEL	/	FAX
参 加 者	氏名	所属・役職	E-mail	手話通訳等の希望

【個人情報の取り扱いについて】

参加申込みにご記入いただいた情報は、本研究会および新潟県からの連絡・情報提供のみ利用させていただきます。